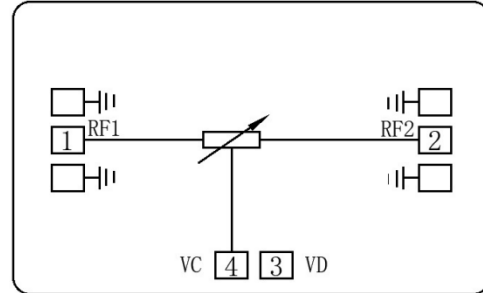




主要特点

- 频率范围: 2 GHz ~ 18 GHz
- 插入损耗: 3.5 dB
- 衰减范围: 3.5 ~ 25 dB
- 输入/输出回波损耗: 15 dB
- 芯片尺寸: 1.5 × 0.8 × 0.1 mm³

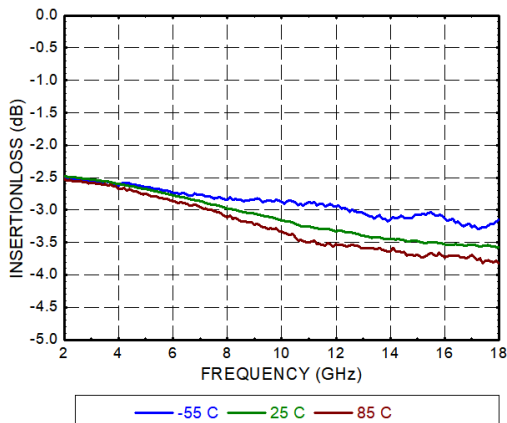
功能框图



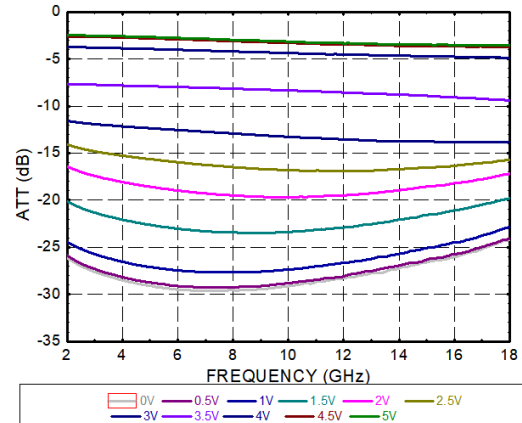
性能指标 ($T_A = +25^\circ\text{C}$, $V_D = +5\text{V}$)

参数	最小	典型	最大	单位
工作频率	2-18			GHz
插入损耗		3.5		dB
衰减范围	3.5-25			dB
输入回波损耗		15		dB
输出回波损耗		15		dB
输入 P-1		14		dBm

插入损耗 VS 温度

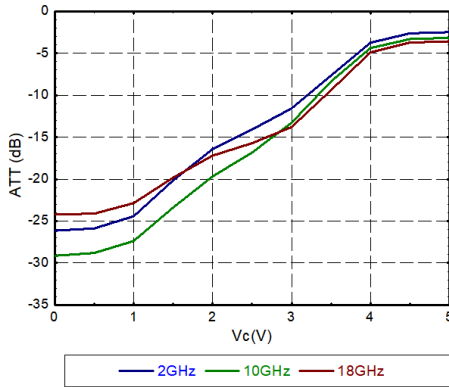


各态衰减量 VS 电压

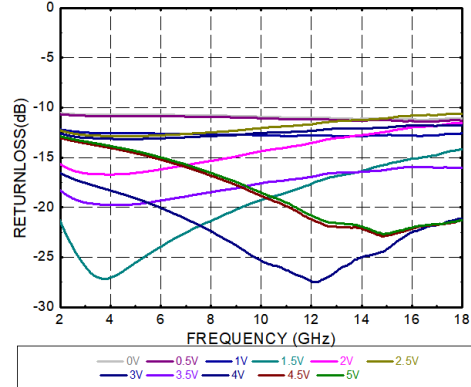




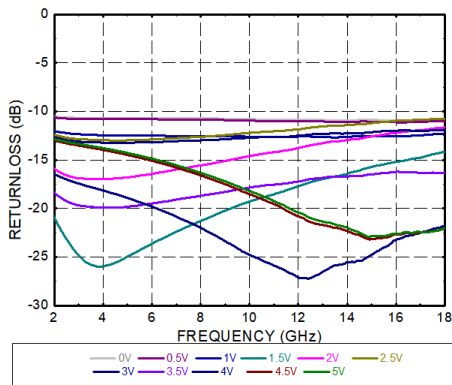
各态衰减量 VS 频率



输入回波损耗 VS 电压

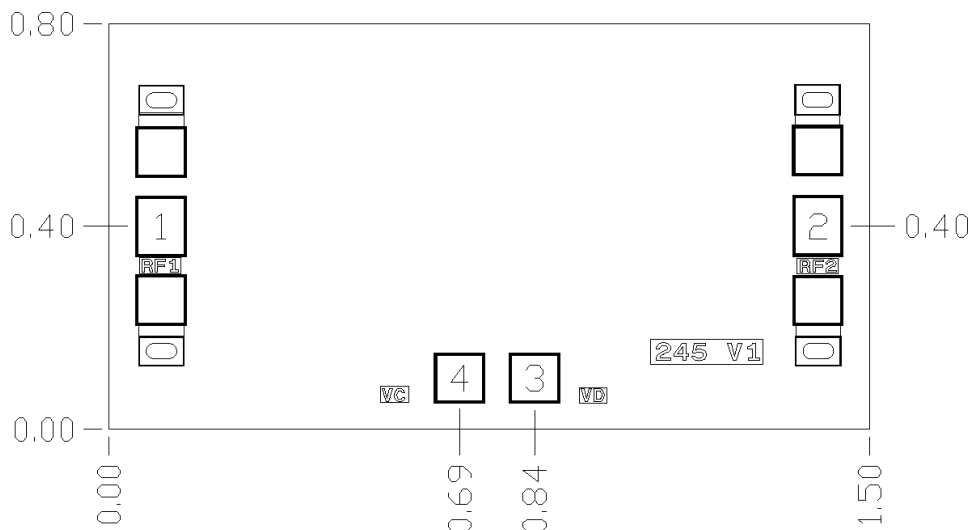


输出回波损耗 VS 电压



物理参数

单位: mm

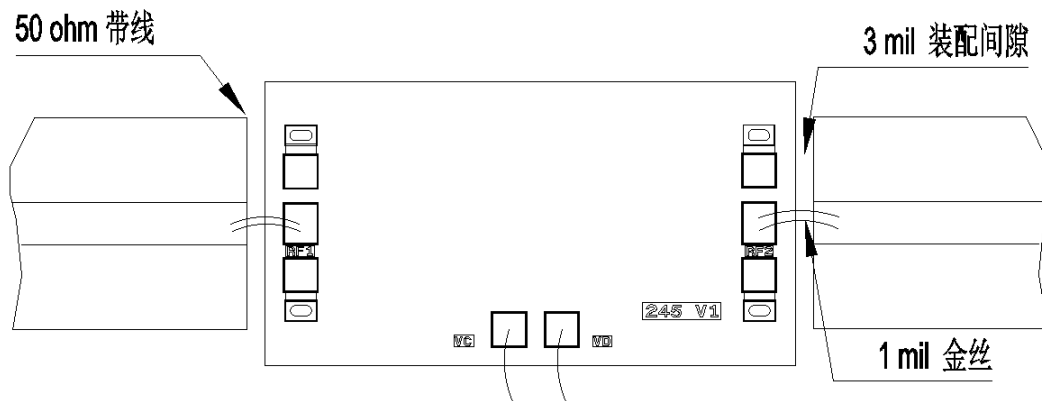




焊盘描述

焊盘序号	功能	描述
1, 2	RF1, RF2	该焊盘是射频端口, AC 耦合, 并匹配至 50Ohm, 不需要外接隔直电容
3	VDD	该焊盘是电源端口
4	VC	该焊盘是控制端口, 控制电压范围为 0 ~ +5V
芯片背面	GND	芯片背面必须连接至 RF/DC 地

推荐装配图



注意事项

1. 本芯片属于静电敏感器件, 运输、存储和使用过程中注意静电防护
2. 芯片厚度为 100 um
3. 键合焊盘金属化: 金
4. 芯片背面镀金
5. 芯片背面接地
6. 未标注的键合焊盘不需要连接
7. 钝化层信息: 材质: SiN; 厚度: 0.5um

极限参数

1. 电源电压: +5.5 V
2. 射频输入功率: +20dBm
3. 储存温度: -65 ~ +150 °C
4. 工作温度: -55 ~ +85 °C